

min. Leiterbahnbreite – 8mils (200micron)

min. Abstand Leiterbahn/Pad – 6mils (200micron)

min. Abstand Leiterbahn/Leiterbahn– 6mils (250micron)

max. Panelabmessungen – 480 x 580mm

min. Platinendicke – 0,1mm

max. Platinendicke – 3,2mm

min. Bohrung – 0,30mm

Schichten – 1...8 Schichten

max. Verhältnis Bohrungsdurchmesser/Platinendicke – 1:4

Lötstopplack– flüssig, fotosensibel

Farben der Lötstopmmaske – dunkelgrün (Standard), gelbgrün, blau, rot, schwarz, weiß

Kupferüberzug in der durchkontaktierten Bohrung > 25micron